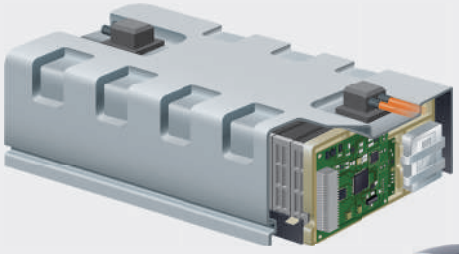
製作焊盤用導電銅膏

擁有 15 年以上樹酯系銅膏製作焊盤的實績

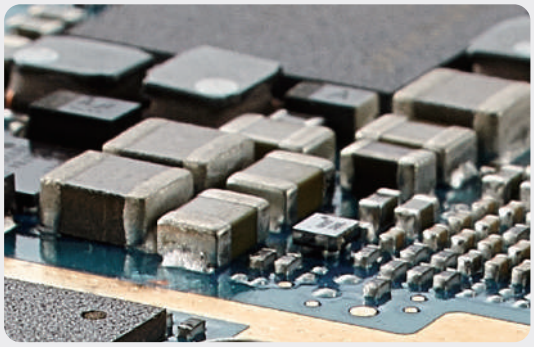
用途

工業用設備，汽車電子零件



圖：汽車

陶瓷電容



主要特性

- 金屬為銀包銅粒子，可有效降低材料成本
- 印刷後擁有優秀的表面均勻性
- 銅膏固化後擁有一定的應力緩衝特性
- 在業界擁有 15 年以上的使用實績

銅膏印刷後

銅膏固化後

產品型錄和特性表

產品型號			NE180	SAP150
特性			熱可塑	熱固化
金屬粒子	種類		銀包銅粉	
	平均粒径	μm	8 ～ 10	4 ～ 6
結合劑	種類		環氧樹酯	Phenol樹酯
溶劑			Butyl carbitol	
金屬粒比率		wt%	90	85
黏度	BH型	dPa・s	70 ～ 90	70 ～ 100
密度		g/cm^3	2.4 ～ 2.6	3.0 ～ 3.4
固化條件			160℃×30分	170℃×30分
體積阻抗率		Ω・cm	1.0 ～ 2.0E-04	
保存期限	0 ～ 10℃	月	4.0	